

中国无线物联网系统级芯片行业发展深度分析与 投资前景研究报告（2023-2030年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国无线物联网系统级芯片行业发展深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202308/650616.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、行业主管部门及监管体制

无线物联网系统级芯片行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，自律组织为中国半导体行业协会。

工信部的主要职责为：为集成电路行业制定发展战略、发展规划并出台相关产业政策、法律、法规、发布行政规章；制定行业相关的技术标准，指导行业技术创新和技术进步；组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究；积极推进与行业相关的科研成果产业化等。

中国半导体行业协会的主要职责为：负责贯彻落实行业相关的政策、法规规章制度；行业自律管理；产业与市场的研究调查，向会员单位和政府主管部门及时提供市场信息和调查数据；代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见；举办本行业国内外新产品、新技术研讨会和展览会；组织行业专业技术人员、管理人员培训等。

工信部与中国半导体行业协会共同构成了集成电路行业的监管体系，各集成电路企业在行业主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，进行市场化的经营。

二、主要法律法规及政策

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出瞄准集成电路等前沿领域实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确将“集成电路设计企业”列为鼓励类企业；《国家信息化发展战略纲要》强调打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路等薄弱环节实现根本性突破；《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》提出启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升；《国家创新驱动发展战略纲要》等文件进一步指出集成电路芯片设计企业的重要地位。

行业主要法律法规及政策	发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
	2022年	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	增强关键技术创新能力。瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽窄结合的物联接入能力。

	2021年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	在事关国家安全和全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。
--	-------	-----	--	--

	2020年	国务院	《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集
--	-------	-----	------------------------------------	--

成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件由工业和信息化部会同相关部门制定。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定。

2020年 工信部办公厅《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》 推进移动物联网应用发展，围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推动移动物联网创新发展。产业数字化方面，深化移动物联网在工业制造、仓储物流、智慧农业、智慧医疗等领域应用，推动设备联网数据采集，提升生产效率。生活智慧化方面，推广移动物联网技术在智能家居、可穿戴设备、儿童及老人照看、宠物追踪等产品中的应用。

2019年 财政部、税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》 依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

2019年 工信部等十三部委《关于印发<制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）>的通知》 在电子信息领域，大力发展集成电路设计，大型计算设备设计，个人计算机及智能终端设计，人工智能时尚创意设计，虚拟现实/增强现实（VR/AR）设备、仿真模拟系统设计等。

2017年 财政部、税务总局《关于集成电路企业增值税期末留抵退税有关城市维护建设税教育费附加和地方教育附加政策的通知》 享受增值税期末留抵退税政策的集成电路企业，其退还的增值税期末留抵税额，应在城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税（征）依据中予以扣除。

2017年 国务院办公厅《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》 鼓励企业自备载运工具的共管共用，提高企业自备载运工具的运用效率。大力推进物联网、无线射频识别（RFID）等信息技术在铁路物流服务中的应用。

2016年 工信部、发改委《信息产业发展指南》 提出丰富智慧家庭产品供给，重点加大智能电视、智能音响、智能服务机器人等新型消费类电子产品供给力度；推动新一代音视频标准研究和应用。

2016年 国务院《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》 启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。

2015年 国务院《中国制造2025》 着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。

2013年 国务院《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》 以掌握原理实现突破性技术创新为目标，把握技术发展方向，围绕应用和产业急需，明确发展重点，加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新，推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。

资料来源：观研天下整理（WWTQ）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国无线物联网系统级芯片行业发展深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国无线物联网系统级芯片行业发展概述

第一节 无线物联网系统级芯片行业发展情况概述

一、无线物联网系统级芯片行业相关定义

二、无线物联网系统级芯片特点分析

三、无线物联网系统级芯片行业基本情况介绍

四、无线物联网系统级芯片行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、无线物联网系统级芯片行业需求主体分析

第二节 中国无线物联网系统级芯片行业生命周期分析

一、无线物联网系统级芯片行业生命周期理论概述

二、无线物联网系统级芯片行业所属的生命周期分析

第三节 无线物联网系统级芯片行业经济指标分析

一、无线物联网系统级芯片行业的赢利性分析

二、无线物联网系统级芯片行业的经济周期分析

三、无线物联网系统级芯片行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球无线物联网系统级芯片行业市场发展现状分析

第一节全球无线物联网系统级芯片行业发展历程回顾

第二节全球无线物联网系统级芯片行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲无线物联网系统级芯片行业地区市场分析

一、亚洲无线物联网系统级芯片行业市场现状分析

二、亚洲无线物联网系统级芯片行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲无线物联网系统级芯片行业市场前景分析

第四节北美无线物联网系统级芯片行业地区市场分析

一、北美无线物联网系统级芯片行业市场现状分析

二、北美无线物联网系统级芯片行业市场规模与市场需求分析

三、北美无线物联网系统级芯片行业市场前景分析

第五节欧洲无线物联网系统级芯片行业地区市场分析

一、欧洲无线物联网系统级芯片行业市场现状分析

二、欧洲无线物联网系统级芯片行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲无线物联网系统级芯片行业市场前景分析

第六节 2023-2030年世界无线物联网系统级芯片行业分布走势预测

第七节 2023-2030年全球无线物联网系统级芯片行业市场规模预测

第三章 中国无线物联网系统级芯片行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对无线物联网系统级芯片行业的影响分析

第三节中国无线物联网系统级芯片行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对无线物联网系统级芯片行业的影响分析

第五节中国无线物联网系统级芯片行业产业社会环境分析

第四章 中国无线物联网系统级芯片行业运行情况

第一节中国无线物联网系统级芯片行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国无线物联网系统级芯片行业市场规模分析

一、影响中国无线物联网系统级芯片行业市场规模的因素

二、中国无线物联网系统级芯片行业市场规模

三、中国无线物联网系统级芯片行业市场规模解析

第三节中国无线物联网系统级芯片行业供应情况分析

一、中国无线物联网系统级芯片行业供应规模

二、中国无线物联网系统级芯片行业供应特点

第四节中国无线物联网系统级芯片行业需求情况分析

一、中国无线物联网系统级芯片行业需求规模

二、中国无线物联网系统级芯片行业需求特点

第五节中国无线物联网系统级芯片行业供需平衡分析

第五章 中国无线物联网系统级芯片行业产业链和细分市场分析

第一节中国无线物联网系统级芯片行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、无线物联网系统级芯片行业产业链图解

第二节中国无线物联网系统级芯片行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对无线物联网系统级芯片行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对无线物联网系统级芯片行业的影响分析

第三节我国无线物联网系统级芯片行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国无线物联网系统级芯片行业市场竞争分析

第一节中国无线物联网系统级芯片行业竞争现状分析

一、中国无线物联网系统级芯片行业竞争格局分析

二、中国无线物联网系统级芯片行业主要品牌分析

第二节中国无线物联网系统级芯片行业集中度分析

一、中国无线物联网系统级芯片行业市场集中度影响因素分析

二、中国无线物联网系统级芯片行业市场集中度分析

第三节中国无线物联网系统级芯片行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

- 二、企业规模分布特征
- 三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国无线物联网系统级芯片行业模型分析

第一节中国无线物联网系统级芯片行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、波特五力模型原理
- 二、供应商议价能力
- 三、购买者议价能力
- 四、新进入者威胁
- 五、替代品威胁
- 六、同业竞争程度
- 七、波特五力模型分析结论

第二节中国无线物联网系统级芯片行业SWOT分析

- 一、SOWT模型概述
- 二、行业优势分析
- 三、行业劣势
- 四、行业机会
- 五、行业威胁
- 六、中国无线物联网系统级芯片行业SWOT分析结论

第三节中国无线物联网系统级芯片行业竞争环境分析（PEST）

- 一、PEST模型概述
- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国无线物联网系统级芯片行业需求特点与动态分析

第一节中国无线物联网系统级芯片行业市场动态情况

第二节中国无线物联网系统级芯片行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节无线物联网系统级芯片行业成本结构分析

第四节 无线物联网系统级芯片行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、其他因素

第五节 中国无线物联网系统级芯片行业价格现状分析

第六节 中国无线物联网系统级芯片行业平均价格走势预测

- 一、中国无线物联网系统级芯片行业平均价格趋势分析
- 二、中国无线物联网系统级芯片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国无线物联网系统级芯片行业所属行业运行数据监测

第一节 中国无线物联网系统级芯片行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节 中国无线物联网系统级芯片行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节 中国无线物联网系统级芯片行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国无线物联网系统级芯片行业区域市场现状分析

第一节 中国无线物联网系统级芯片行业区域市场规模分析

- 一、影响无线物联网系统级芯片行业区域市场分布的因素
- 二、中国无线物联网系统级芯片行业区域市场分布

第二节 中国华东地区无线物联网系统级芯片行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区无线物联网系统级芯片行业市场分析
 - (1) 华东地区无线物联网系统级芯片行业市场规模
 - (2) 华南地区无线物联网系统级芯片行业市场现状

(3) 华东地区无线物联网系统级芯片行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区无线物联网系统级芯片行业市场分析

(1) 华中地区无线物联网系统级芯片行业市场规模

(2) 华中地区无线物联网系统级芯片行业市场现状

(3) 华中地区无线物联网系统级芯片行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区无线物联网系统级芯片行业市场分析

(1) 华南地区无线物联网系统级芯片行业市场规模

(2) 华南地区无线物联网系统级芯片行业市场现状

(3) 华南地区无线物联网系统级芯片行业市场规模预测

第五节华北地区无线物联网系统级芯片行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区无线物联网系统级芯片行业市场分析

(1) 华北地区无线物联网系统级芯片行业市场规模

(2) 华北地区无线物联网系统级芯片行业市场现状

(3) 华北地区无线物联网系统级芯片行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区无线物联网系统级芯片行业市场分析

(1) 东北地区无线物联网系统级芯片行业市场规模

(2) 东北地区无线物联网系统级芯片行业市场现状

(3) 东北地区无线物联网系统级芯片行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区无线物联网系统级芯片行业市场分析

(1) 西南地区无线物联网系统级芯片行业市场规模

(2) 西南地区无线物联网系统级芯片行业市场现状

(3) 西南地区无线物联网系统级芯片行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区无线物联网系统级芯片行业市场分析

(1) 西北地区无线物联网系统级芯片行业市场规模

(2) 西北地区无线物联网系统级芯片行业市场现状

(3) 西北地区无线物联网系统级芯片行业市场规模预测

第十一章 无线物联网系统级芯片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第六节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第七节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第八节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第九节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十二章 2023-2030年中国无线物联网系统级芯片行业发展前景分析与预测

第一节 中国无线物联网系统级芯片行业未来发展前景分析

- 一、无线物联网系统级芯片行业国内投资环境分析
- 二、中国无线物联网系统级芯片行业市场机会分析

三、中国无线物联网系统级芯片行业投资增速预测

第二节中国无线物联网系统级芯片行业未来发展趋势预测

第三节中国无线物联网系统级芯片行业规模发展预测

一、中国无线物联网系统级芯片行业市场规模预测

二、中国无线物联网系统级芯片行业市场规模增速预测

三、中国无线物联网系统级芯片行业产值规模预测

四、中国无线物联网系统级芯片行业产值增速预测

五、中国无线物联网系统级芯片行业供需情况预测

第四节中国无线物联网系统级芯片行业盈利走势预测

第十三章 2023-2030年中国无线物联网系统级芯片行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国无线物联网系统级芯片行业进入壁垒分析

一、无线物联网系统级芯片行业资金壁垒分析

二、无线物联网系统级芯片行业技术壁垒分析

三、无线物联网系统级芯片行业人才壁垒分析

四、无线物联网系统级芯片行业品牌壁垒分析

五、无线物联网系统级芯片行业其他壁垒分析

第二节无线物联网系统级芯片行业风险分析

一、无线物联网系统级芯片行业宏观环境风险

二、无线物联网系统级芯片行业技术风险

三、无线物联网系统级芯片行业竞争风险

四、无线物联网系统级芯片行业其他风险

第三节中国无线物联网系统级芯片行业存在的问题

第四节中国无线物联网系统级芯片行业解决问题的策略分析

第十四章 2023-2030年中国无线物联网系统级芯片行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国无线物联网系统级芯片行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国无线物联网系统级芯片行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 无线物联网系统级芯片行业营销策略分析

一、无线物联网系统级芯片行业产品策略

二、无线物联网系统级芯片行业定价策略

三、无线物联网系统级芯片行业渠道策略

四、无线物联网系统级芯片行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202308/650616.html>